

BGA115下压探针老化座0.8间距12*18mm尺寸

产品名称	BGA115下压探针老化座0.8间距12*18mm尺寸
公司名称	深圳德诺嘉电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HMILU 型号:BGA115-0.8测试 产地:深圳
公司地址	宝安区西乡街道劳动社区圣淘沙骏园A单元1103
联系电话	0755-23287415 13823337462

产品详情

产品特点：

- 1、本品为下压结构测试座；
- 2、适用于间距为0.8mm的BGA封装芯片；
- 3、紧凑的设计和较小的测试压力；
- 4、独特的结构避免卡球；
- 5、可更换限位框，高精度的定位槽和导向孔，测试准确无误；
- 6、根据实际测试情况，选用不同探针，可以对IC进行有锡球、无锡球不同测试；
- 7、人性化设计，探针可更换，便于拆卸、维护，降低测试成本；

8、进口探针、工程材料结合高精度制作设备，socket测试更稳定，使用寿命更长。

产品参数：

适用封装芯片为：BGA115pin 间距为0.8mm 尺寸：12*18mm

1、绝缘抗阻: 1000M Min.At DC 500V 2、耐电压：1 Minute At AC 700V

3、接触抗阻：30m or less at 10mA and 20mV (Initial)

4、额定电流: 1A 5、工作温度：

-55 —+175 6、接触压力：8-10g Pin (Normal)

7、使用寿命：15,000 Times (Mechanical) 8、工作压力：2.0

Kg MAX